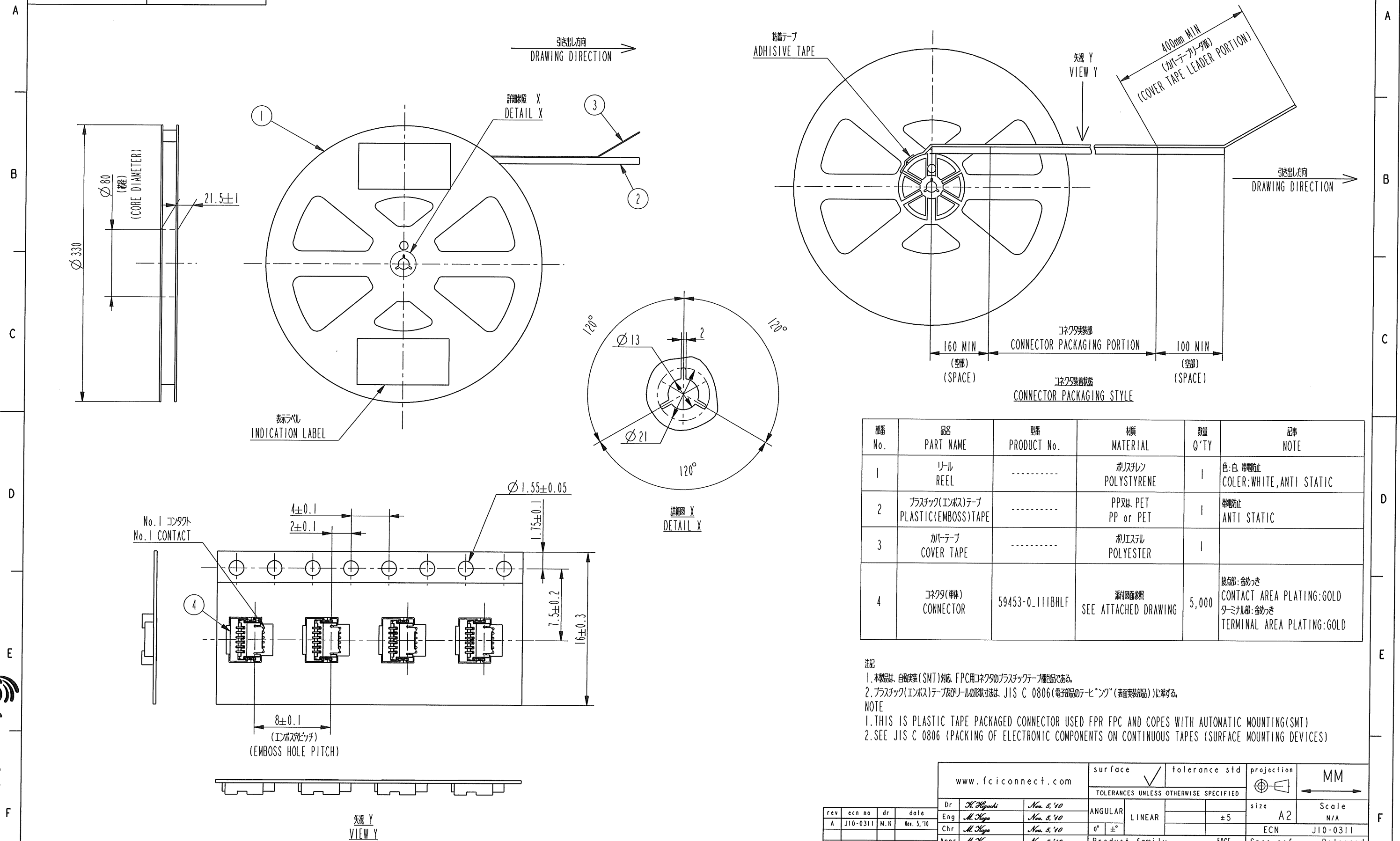
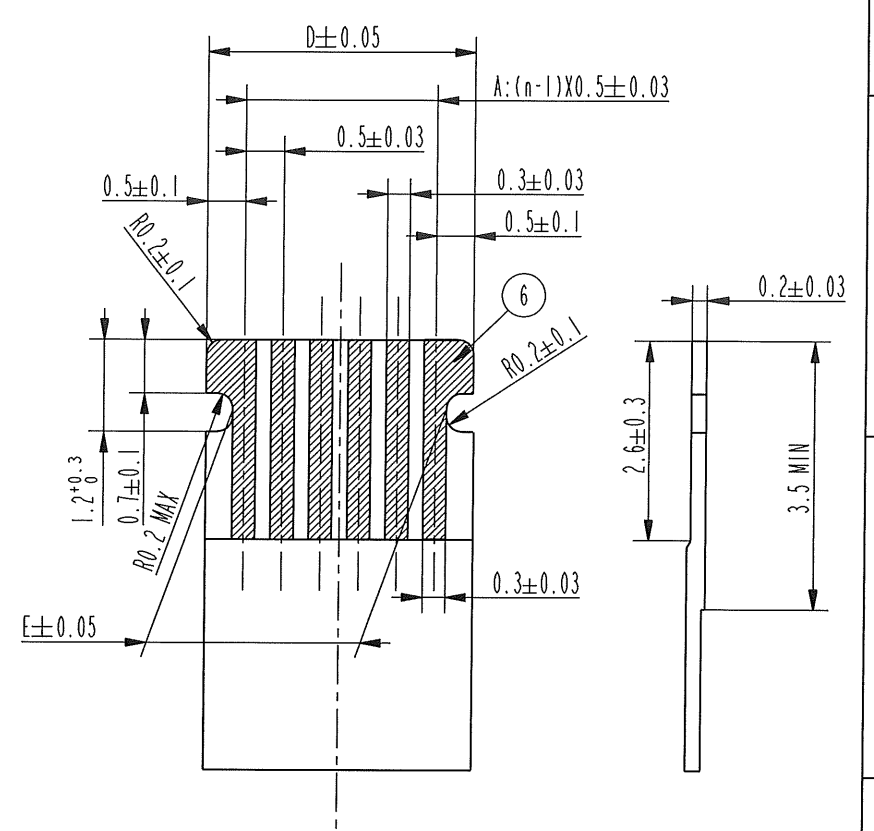
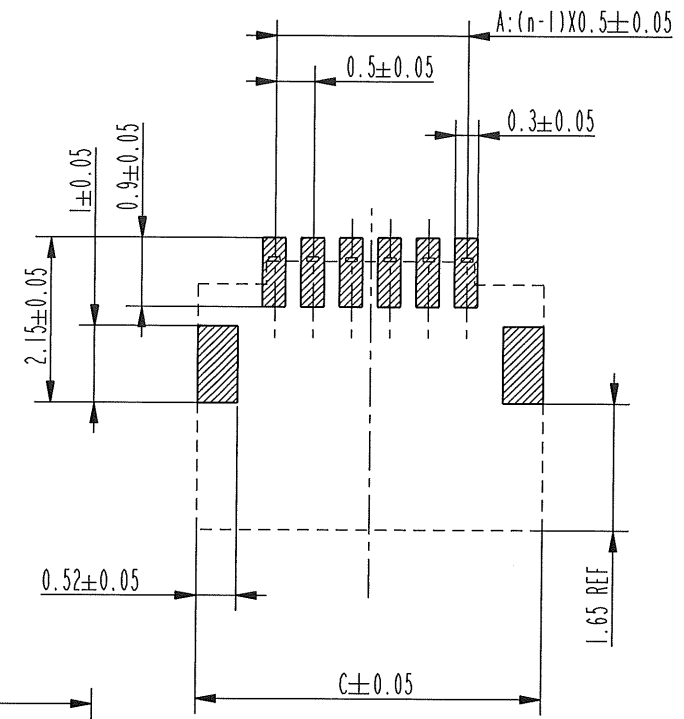
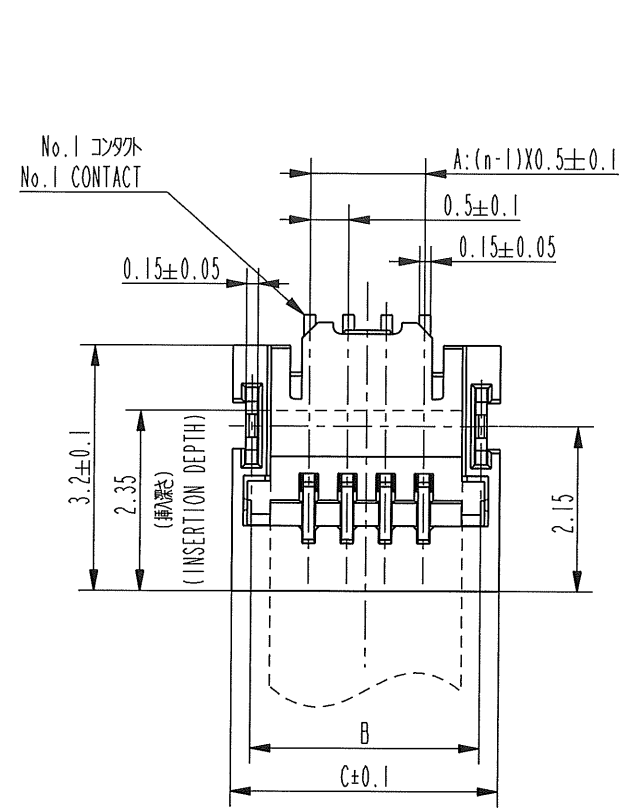


1		2	3	4	5	6	7	8
PRODUCT No.	No. OF CONTACTS							
59453-041110EBHLF	4 CONTACTS							
59453-051110EBHLF	5 CONTACTS							



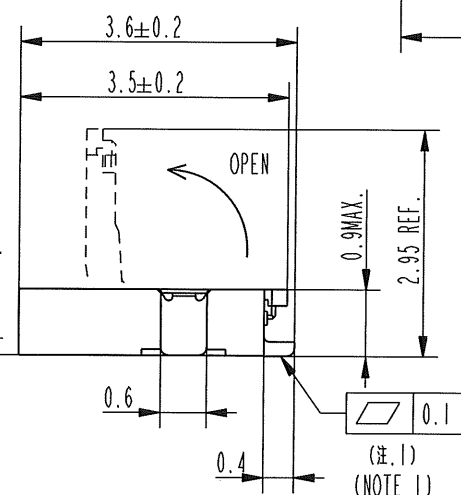
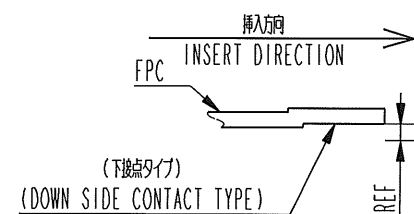
推奨基板パターン図
RECOMMENDED PCB LAYOUT

推奨FPC寸法
RECOMMENDED FPC



CONNECTOR PARTS LIST

部品番号 No.	部品名 PART NAME	材料 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入り耐熱樹脂 UL94V-0 GLASS FILLED THERMOPLASTIC RESIN	1	色:黒, ハロゲンフリー COLOR:BLACK, HALOGEN FREE
2	アクチュエータ ACTUATOR	ガラス繊維入り耐熱樹脂 GLASS FILLED THERMOPLASTIC RESIN	1	色:黒, ハロゲンフリー COLOR:BLACK, HALOGEN FREE
3	コンタクト CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	n	接点部:金めっき CONTACT AREA PLATING:GOLD 端子部:金めっき TERMINAL AREA PLATING:GOLD
4	補強金具 FIXING TAB	黄銅 BRASS	2	めっき:錫めっき(鉛フリー) PLATING:TIN(LEAD FREE)



PRODUCT No. AND DIMENSIONS

PRODUCT No. (Not emboss packaging)	DIMENSIONS				
	A	B	C	D	E
59453-0411BHLF(4 CONTACTS)	1.5	3.0	3.5	2.5	1.8
59453-0511BHLF(5 CONTACTS)	2.0	3.5	4.0	3.0	2.3

FPC PARTS LIST

部品番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	記事 NOTE
5	ベースフィルム BASE FILM	ポリイミド POLYIMIDE	
6	導体 CONDUCTOR	銅箔 金めっき 0.1μm以上 COPPER FOIL(PLATING:GOLD 0.1μm)	
7	オーバーレイ OVER LAY	ポリイミド POLYIMIDE	
8	補強板 SUPPORTING TAPE	ポリイミド POLYIMIDE	

注記
熱硬化接着剤を使用し、接合方式は熱圧着とする。

NOTE
ADHISIVE METHOD OF SUPPORTING TAPE SHALL BE HEAT CRIMPING METHOD AND THERMOSETTING ADHISIVE SHALL BE USED

注記/NOTE
1. コントクト、補強金具の平坦度は0.1以内
1.COPLANARITY FOR CONTACT TERMINAL AND FIXING TAB MUST BE WITHIN 0.1mm.
2. 本製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ指令と他国の規制に適合しています。
2.THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

www.fciconnect.com			surface 		tolerance std		projection 		MM 	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
Dr	K. Hiyoshi	Nov. 5, '10	ANGULAR	LINEAR		size	A2	Scale	N/A	
Eng	M. Koga	Nov. 5, '10								±0.3
Chr	M. Koga	Nov. 5, '10	0°	±°	ECN			J10-0311		
Appr	M. Koga	Nov. 5, '10	Product family			59CF		Spec ref	Released	
			title			59453			Rev.	
			PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR (DOWN SIDE CONTACT TYPE)						A	
			catalog no			CUSTOMER			sheet 2 of 2	